

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 10 月 27 日 (27.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/101125 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G03F 7/037, 7/038, 7/023, C08G 73/10, 73/22
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004666
- (22) 国際出願日: 2004 年 3 月 31 日 (31.03.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成デュポンマイクロシステムズ株式会社 (HITACHI CHEMICAL DUPONT MICROSYSTEMS LTD.) [JP/JP]; 〒1120002 東京都文京区小石川一丁目 4 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小松 博 (KOMATSU, Hiroshi) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東

町四丁目 1 3 番 1 号 日立化成デュポンマイクロシステムズ株式会社 山崎センタ内 Ibaraki (JP). 藤枝 永敏 (FUJIEDA, Nagatoshi) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号 日立化成デュポンマイクロシステムズ株式会社 山崎センタ内 Ibaraki (JP). 中野一 (NAKANO, Hajime) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号 日立化成デュポンマイクロシステムズ株式会社 山崎センタ内 Ibaraki (JP).

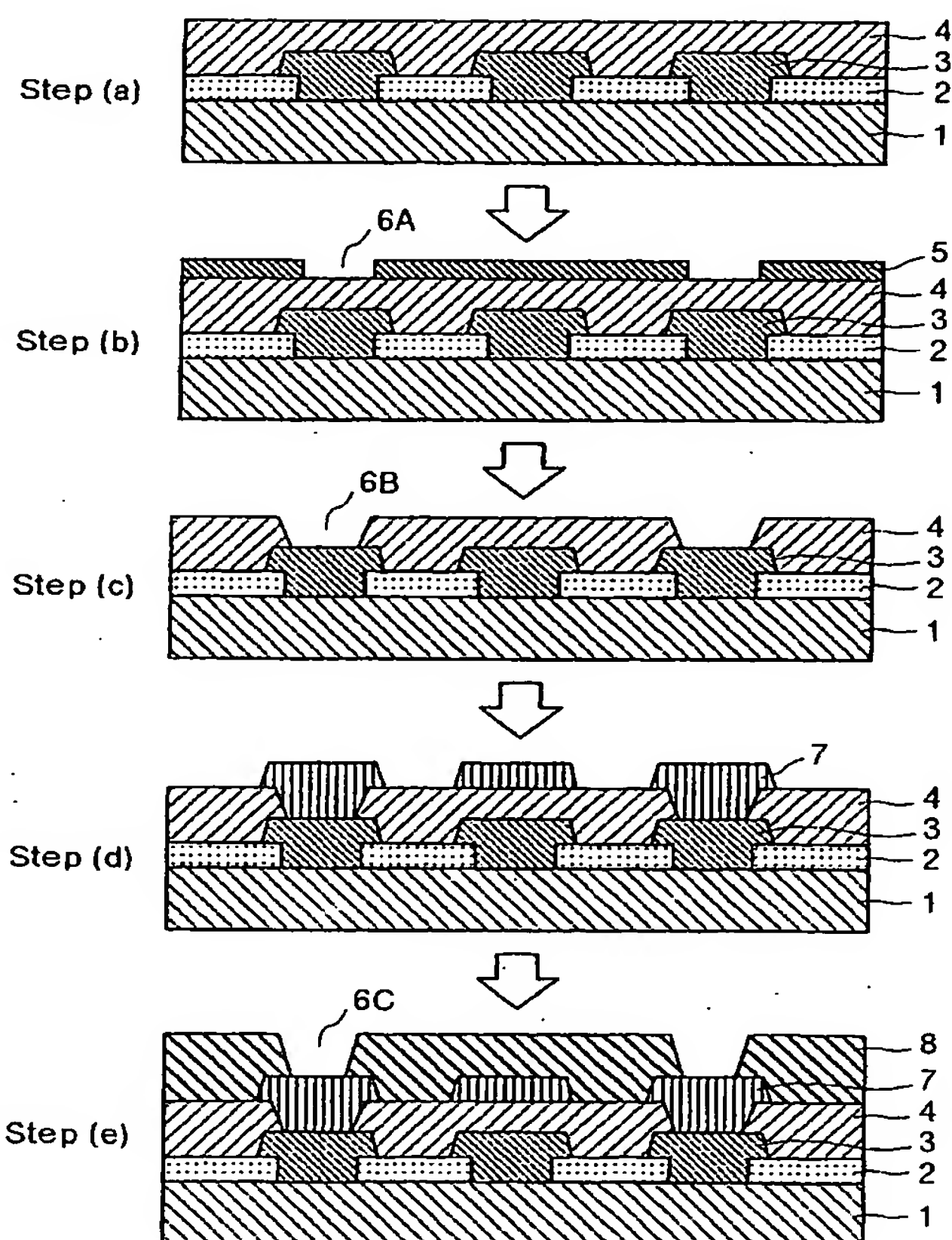
(74) 代理人: 酒井 宏明 (SAKAI, Hiroaki); 〒1006019 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビルディング 酒井国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

[続葉有]

(54) Title: HEAT-RESISTANT PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PROCESS FOR PRODUCING PATTERN FROM THE COMPOSITION, AND ELECTRONIC PART

(54) 発明の名称: 耐熱感光性樹脂組成物、該組成物を用いたパターン製造方法、及び電子部品



(57) Abstract: A heat-resistant photosensitive resin composition which comprises (A) a polymer having an acidic functional group and/or a substituent derived therefrom, (B) a compound having at least one substituent derived from an amine-derived functional group, (C) a photoreactive compound, and (D) a solvent. Due to this constitution, the composition gives a cured film having satisfactory properties. A pattern having satisfactory resolution can be produced from this photosensitive resin composition, and a high-quality electronic part can be provided with the pattern.

(57) 要約: (A) 酸性官能基及び／又はその誘導置換基を有する重合体と、(B) アミン官能基から誘導される置換基を少なくとも一つ有する化合物と、(C) 光反応性化合物と、及び (D) 溶媒とを含有して感光性樹脂組成物を構成することによって、良好な硬化膜物性を有する耐熱感光性樹脂組成物を提供することができ、この感光性樹脂組成物を使用して解像性の良好なパターンの製造することができ、ひいては高品質な電子部品を提供することができる。



LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CL, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

--- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。